

元器件生产厂商自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则》的相关要求，对我单位研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 3 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 3 项、C 级 0 项、C*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表 1；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表 2。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。
特此承诺。

元器件生产厂商名称（鉴章）

2026 年 05 月 12 日

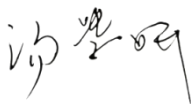
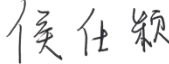


附表 1 电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	一级分类 ^a	二级分类 ^a	三级分类 ^a	元器件名称 ^b	型号规格 ^c	生产厂商 ^d	自主可控等级 ^e	是否“伪国产化” ^f		是否“包装国产化” ^f		是否“空心国产化” ^f		备注 ^g
								是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	半导体集成电路	总线与接口器件	总线接口器件	总线缓冲器	JTLX29617XM	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	半导体集成电路	总线与接口器件	总线接口器件	总线缓冲器	JTLX29617XM(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	半导体集成电路	总线与接口器件	总线接口器件	总线缓冲器	TLX29617XM	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明：

- ^a. 一级、二级、三级分类按 ZKB 3101-002-2024 附录 A 填写；
- ^b. 元器件名称：应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- ^c. 型号规格：应填写元器件完整型号规格；
- ^d. 生产厂商：应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- ^e. 自主可控等级：按照 ZKB 3101-001-2022 执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
- ^f. 伪空包“伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2024 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- ^g. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。

填报单位（盖章）： 法定代表人（签章）： 填表人（签字）： 电话：13699386074 填报日期：20260512

附表 2 电子元器件基本信息表

序号	一级分类 ^a	二级分类 ^a	三级分类 ^a	元器件名称 ^b	型号规格 ^c	使用 IP 核情况 ^d				原材料和零部件 ^e				流片工艺 ^h		备注 ⁱ
						名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^f	来源单位 ^g	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	半导体集成电路	总线与接口器件	总线接口器件	总线缓冲器	JTLX29617XM	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
2	半导体集成电路	总线与接口器件	总线接口器件	总线缓冲器	JTLX29617XM(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
3	半导体集成电路	总线与接口器件	总线接口器件	总线缓冲器	TLX29617XM	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填表说明:

- ^a. 一级、二级、三级分类按 ZKB 3101-002-2024 附录 A 填写;
- ^b. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
- ^c. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
- ^d. 使用 IP 核情况: 仅适用于半导体集成电路, 应填写 IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;
- ^e. 原材料和零部件: 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含 ZKB 3101-002-2024 标准附录 A 中内部零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;

填报单位(盖章): 法定代表人(签章): 侯仕颖 填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20260512

- ^f. 是否“核心”/“关键”: 应根据 ZKB 3101-002-2024 标准附录 A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;
- ^g. 来源单位: 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;
- ^h. 流片工艺: 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如 45nmBCD 工艺等, 必要时在备注中填写流片厂商信息;
- ⁱ. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

汤学研

填表人(签字):

侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20260512